

Global Metal Platform Service Provider

SEOJIN SYSTEM

Investor Relations 2018



본 자료는 주주 및 기관투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보 제공을 목적으로
주식회사 서진시스템(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 presentation에의 참
석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당 될 수
있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된“예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황
및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, (E)’등과 같은 단어를 포함합니다. 위“예측정보”는 향후 경영환경의 변화등에 따라 영향을
받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은“예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생
할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환
경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는
근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

독창적인 기술력 확보를 통해
최고 품질의 제품생산 및 불량률 제로에
도전하고 있습니다.

< CONTENTS >

1. 회사 소개 및 핵심 역량
2. 경영 실적 및 사업 현황
3. Appendix

Chapter1.

회사 소개 및 핵심 역량

1. 회사 개요

품질 경영을 통한 고객 감동을 실현하는 서진시스템

일반 현황

회사명	주식회사 서진시스템	임직원수	8,907명 (연결기준, 2018. 5월 기준)
대표이사	전 동 규	사업분야	기타무선통신장비제조업
설립일	1996.07월 (법인전환일 : 2007.10월)	주요제품	통신장비부품, 휴대폰메탈케이스, 반도체장비 등
자본금	31억원 (2018. 5월 기준)	본점소재지	경기도 부천시 오정구 산업로 20-22

주요 연혁

2007-2010

통신부품
다이캐스팅 및 메탈 가공

2009.01 TS16949:2002 인증
2008.06 GM대우자동차 협력업체 등록 (FA부문)
2008.04 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증
2008.03 서진시스템 기술연구소 인증
2007.08 (주)서진시스템으로 법인 전환

2011-2014

베트남 진출
스마트폰 Metal Case

2014.11 베트남 법인 설립(서진비나)
2014.10 스마트폰 메탈케이스 가공 개시
2014.05 중국 심천 법인 설립 (서진일렉트로닉시스템)
2013.10 삼성전자 네트워크사업부 공급 개시
2011.11 베트남 법인 설립 (서진시스템비나)

2015 - 현재

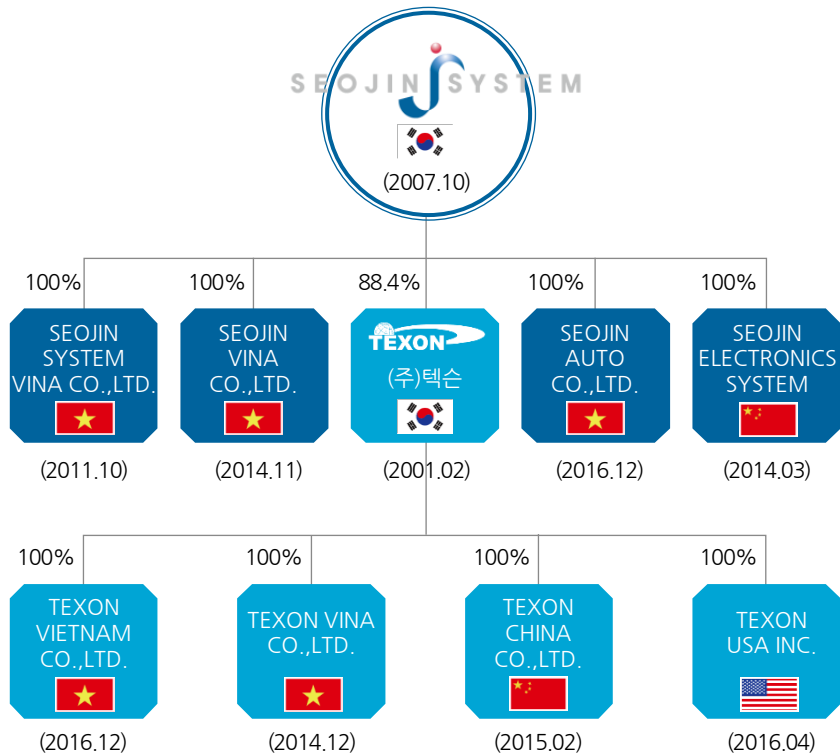
반도체, ESS 등 사업 다각화 및
EMS 확장

2018.02 서진오토 / 텍슨 베트남 가동
2017.03 KOSDAQ 시장 상장
2016.12 베트남 법인 설립 (서진오토)
2016.11 전기차 배터리 케이스 제조 관련 특허 등록
2016.08 베트남 신공장 (알루미늄 잉곳 양산) 완공
2015.12 주식회사 텍슨 인수
2015.02 서진비나 CNC머신 라인 완공

2. 자회사 및 공장 현황

2011년 베트남에 진출 → 연결법인 5개사, 대규모 생산 설비 구축, 특히 2018년 1Q 신규 공장 증설

자회사 현황



현지 법인 및 공장 현황



	서진시스템 비나	서진 비나	서진 오토	텍슨 베트남	텍슨 비나
사업장 위치	박닌성 띠엔센 공단				박장성 반트롱 공단
생산제품	통신 / 가전	잉곳/모바일	자동차 / 신규사업 등	통신 / ESS/ 반도체	통신 / ESS
대지 (㎡)	32,825	42,200	80,682	49,865	10,000
건평 (㎡)	46,200	53,240	134,055	120,543	5,290
생산인력 (명)	2,212	4,917	802	483	122
설립년월	2011.10	2014.11	2016.12	2016.12	2014.12

3. 생산 공정 및 규모

국내 약 20여개 중소기업의 생산 공정을 서진시스템이 베트남에서 수직계열화를 통해 모두 수행 가능



4. 사업영역 및 주요 제품

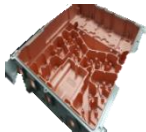
다양한 High-Tech 산업에 적용되는 핵심 부품, 케이스 등 생산

통신장비 케이스 및 부품

RRH장비



필터하우징



셋톱박스하우징



중계기



셋톱박스



실프, 팬, PCB



Cabinet



반도체 장비 및 부품

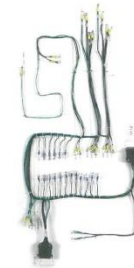
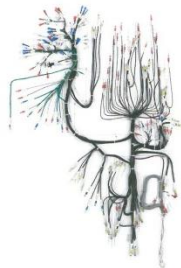
식각장비



증착장비



컨트롤박스



ESS 장비

Battery Rack



BCP



UPS



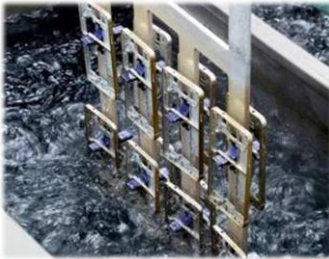
※ BCP(Battery Control Panel)

※ UPS(Uninterruptible Power Supply): 무정전 전원 장치

4. 사업영역 및 주요 제품

다양한 High-Tech 산업에 적용되는 핵심 부품, 케이스 등 생산

모바일 메탈케이스, EMS 서비스



Sub-Assembly

TRI

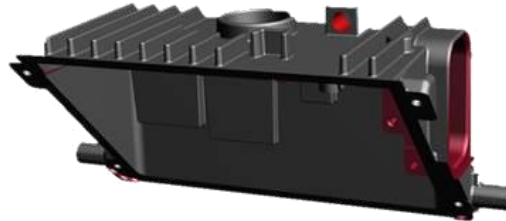
Back Glass

아노다이징

Kitting

Metal Rear

자동차 부품



중공업



Chapter2.

경영 실적 및 사업 현황

1. 사업 Highlights (설립 이후~현재)

글로벌 고객사와의 기반을 바탕으로 다양한 사업부문 안정화 단계 진입



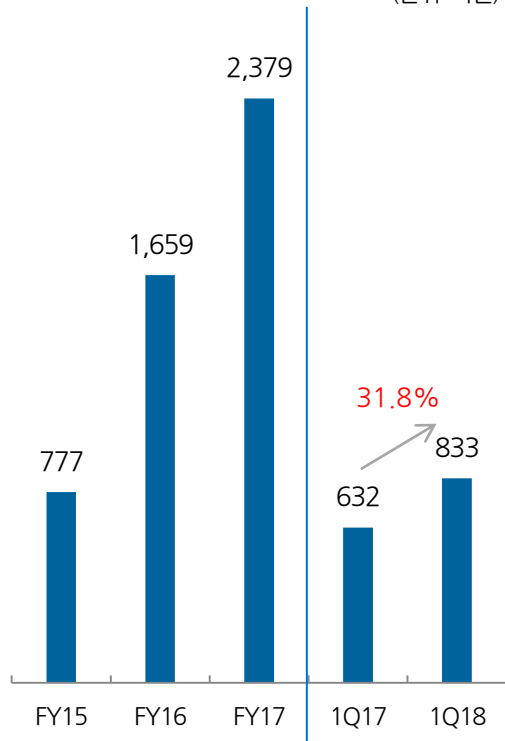
2. 실적 요약

2018년 1분기 매출 833억원, 영업이익 96억원, 당기순이익 86억원 기록

- ▶ 유형자산(시설, 기계장치 등) 취득가액 지속 증가에 따라 감가상각비 원가 반영에도 불구하고 영업이익률 10% 이상 기록
- ▶ 2018년 1Q, 삼성전자向 통신 매출 비중의 증가로 매출 상승, 환율 역시 안정화되며 순이익 YoY 258% 고성장

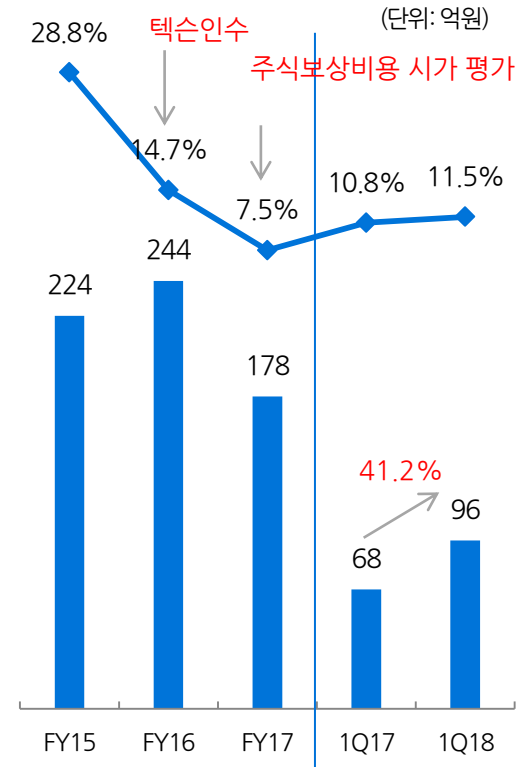
매출액

(단위: 억원)



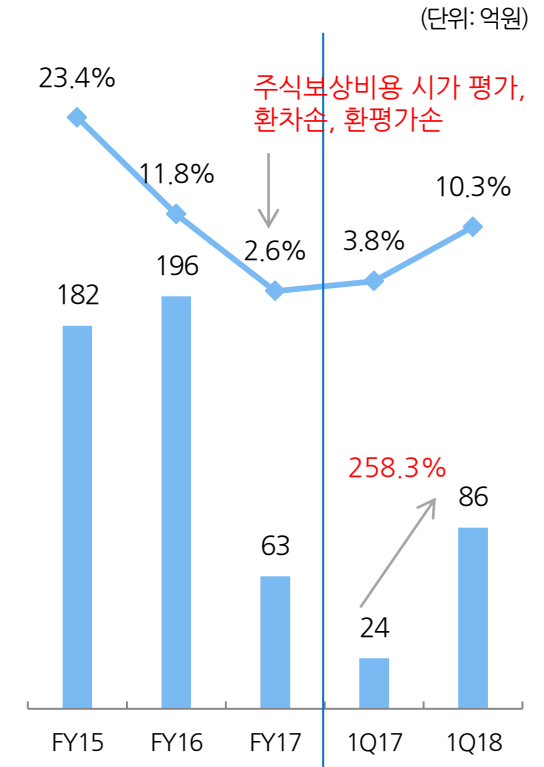
영업이익(률)

(단위: 억원)



당기순이익

(단위: 억원)



4. 유상증자 현황 (2018.05.16 공시)

대표이사 100% 청약을 통해 시설투자를 위한 약 700억 규모 유상증자 결정

유상증자 개요

발행주식수	2,661,596주
배정비율	1: 0.4166주
모집가액(예정)	26,300원
모집총액(예정)	700억원
모집방법	주주배정후 실권주 일반공모

※ 모집가액 및 모집총액은 이사회결의일 전일 기준으로 산정한 예정 가액입니다.

유상증자 향후 일정(예정)

권리락	6월 19일
발행가액확정	1차 확정: 6월 15일 / 2차 확정: 7월 18일
청약예정	구주주 및 초과청약: 07월 23일~24일 일반공모: 07월 26일~27일
신주상장예정	08월 13일

자금 사용 내역

구분		금액	투자완료 예정
기계설비	CNC 등	500억원	4Q18
시설비	급배수시설, 변압기 공조, 냉난방 등	100억원	4Q18
제조설비	아노다이징, 압출라인 등	100억원	1Q19

주주 현황

구분	소유주식수(주)	지분율 (%)
대표이사	2,635,710	42.18
우리사주조합	134,254	2.15
기타	3,478,773	55.67
소계	6,248,737	100.00

※ 주식매수선택권 140,000주 포함시 총 주식수 6,388,737주

5. 2018년 Highlights

상반기, 삼성전자向 통신부문 매출의 고성장이 실적 견인 → 하반기, 반도체, ESS 등으로 모멘텀 확대

하이엔드 모델

▪ S, Note 시리즈

중저가 모델

▪ A, J 시리즈

기타 모델

▪ 갤럭시탭 시리즈



SAMSUNG
삼성SDI

+α

▪ Partnership 강화

▪ 추가 고객사 확보

▪ 중공업(효성, GE, 히다찌)
▪ 가전
▪ LED

통신

모바일

반도체

ESS

자동차

ETC

Sprint • 샘플 공급으로 테스트 진행中

RELIANCE

• 하반기 까지 대규모 매출 발생 예정 (삼성전자向)



• 2017. 05월 이후 매출 지속 및 신제품 개발 직접공급

• VERIZON, KT, SK, AT&T, KDDI 등 5G 진행

LamKOREA
RESEARCH

▪ 삼성전자, SK하이닉스向 독점 공급 지속
▪ 케이스 매출 확대 / 하네스 외 부품 사업 확대

LamGlobal
RESEARCH

▪ 본사와 2016년 부터 R&D 공동 참여



Valeo

• '18년 10여종 승인 후 공급 수량 확대



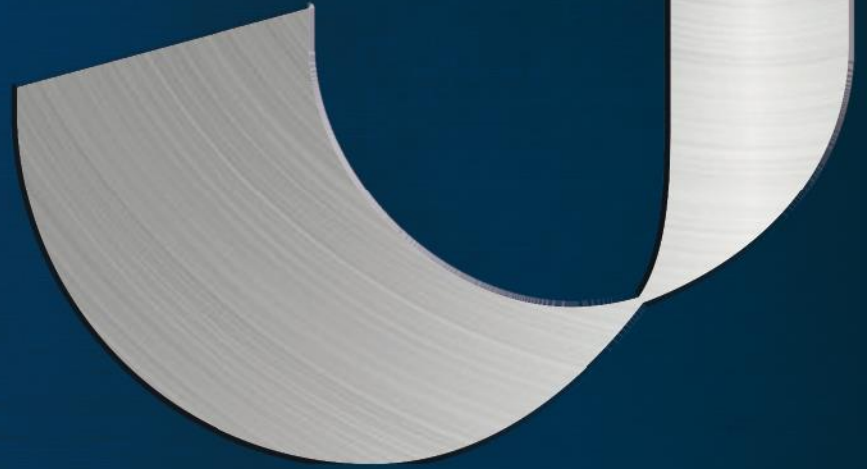
• 자동차 범퍼 '18.1Q 매출 시작

HITACHI
Inspire the Next

• 신칸센 고속철 모터 케이스 매출 지속

+α

• 전기차 배터리 함체 공급 논의중



Appendix.

재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2015	2016	2017	2018.1Q
유동자산	49,748	98,157	110,287	155,798
비유동자산	98,141	129,166	148,945	155,606
자산총계	146,090	227,323	259,232	312,404
유동부채	79,238	130,033	125,034	165,179
비유동부채	33,114	24,786	12,902	17,151
부채총계	112,351	154,819	137,936	182,330
자본금	1,500	2,151	3,124	3,124
주식발행초과금	-	23,673	65,952	65,952
기타자본	10,376	5,317	9,072	9,186
기타포괄손익누계	1,706	1,684	(3,373)	(3,573)
이익잉여금	20,157	39,679	43,937	52,229
비지배지분			2,584	3,156
자본총계	33,739	72,504	121,296	130,074

손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2015	2016	2017	2018.1Q
매출액	77,742	165,871	237,946	83,275
매출원가	45,059	123,309	194,398	67,435
매출총이익	32,683	42,562	43,548	15,840
판매관리비	10,235	18,171	25,701	6,234
영업이익	22,449	24,391	17,847	9,607
금융수익	1,589	5,650	2,987	1,234
금융비용	6,412	9,421	13,176	2,688
기타수익	734	673	2,219	717
기타비용	481	714	2,474	303
법인세차감전순이익	17,878	20,578	7,403	8,569
당기순이익	18,247	19,627	6,310	8,640